**2017年9月份工作报告**

报告人： 谭亮 日期：2017/10/10

1. 本季度订单交易情况小结
2. 客户订单情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | **产品类型** | **数量** | **金额** |
| HUAWEI | T75B-H529-10.00MHz | 6600 | 105791.4 |
| 国家频谱管理研究所 | O22B-G426-100.00MHz | 10 | 22000 |
| 广瑞泰 | T75B-F319-40.00MHz-A | 300 | 9600 |
| 成都讯隆 | T75B-G511-50.00MHz | 20 | 2400 |
| Chronos | ACS9522IFALBGT | 504 | 60041.52 |
| 成都华康新联科技 | M21B-ESBD-10.00MHz | 11 | 3850 |
| 北京华森国际 | OS754-D31-90.00MHz | 10 | 280 |
| 北京华森国际 | V756-B712-125.00MHz | 10 | 1250 |
| 北京华森国际 | T75B-F319-10.00MHz | 10 | 800 |
| 成都兴仁科技 | M75B-H413-10.00MHz | 10 | 2200 |
| 电子科大科园 | T75B-M319-80.00MHz | 20 | 5200 |
| 汇总 | 　 | 　 | 213412.92 |

二、月度总结

2.1 海外市场

1. 9月份海外市场，芯片主要就是chronos下了504pcs的ACS9522订单，预计11月份出货，其他客户没有订单。
2. Chronos 有送样O22B 高低两款样品，目前O22B高指标样品在测，低指标的等客户重新设计板子再测
3. Leader样品已经收到，客户端在等待PCB贴片组装测试中
4. Valiant 晶振样品需求跟进，10月份出货
5. ACALBFI 晶振询价，样品之前有T75寄出，等待客户端测试反馈
6. 其他客户保持联系，暂时没有实质需求

2.2 国内市场

1. 华为T75B 10.00MHz 订单稳定，6600pcs，比预测少600pcs
2. 华为T75B 10.00MHz因为IQC 回流焊掉盖导致退货，原因在协助华为调查。相关文件已发给华为，评审现场发现的问题也提交整改的对策。华为IQC现场参观机会等待安排
3. 华为O11F 38.88M 替代测试目前已启动，预计10月份会完成，跟进成都和西安的测试情况及进度；可靠性测试预计10份完成，跟进夏工那边的最新情况
4. O11H 10M 目前晶体延迟发货，预计最快能提供样品的时间要到11月底才能提供摸底测试样品
5. 华为 105度宽温低噪TCXO 目前方案还未最终定型，新来的谐振器温度特性达不到要求，1hz相噪也不够余量
6. 高保持方案，10月中下旬再跟屈涛沟通，看他们那边的测试结果，是否给机会我们送样
7. 陕西烽火电子T53 16M已出完货，款要10与份到期；备一点晶体库存，11月份有可能还有订单
8. 福建三元达，O22B已出货，款10月份到期， T10A也已出货。
9. 珠海高凌，应军改，其网络产品需求暂停，跟进客户端最新的动静
10. 广州慧睿思通，O11A样品需求，10月份发样品
11. 其他小客户跟进一些样品订单
12. 张振华客户，大多数客户都已电话沟通了一遍，通知了相关情况，一些客户的小订单下达。还有一些样品出货，逾期款追缴工作
	* 1. 新客户和Design in

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 项目 | 大普产品机会 | 状态 | 进度 |
| Chronos | SyncBox | 晶振 O22 | Design in | 目前在测试当中 |
| ECI | Apollo | ACS9522 | Design in | 基本完成，批量订单要等招标等机会 |
| CDOT | GPON | ACS9522 /晶振 | Design in | 4季度完成测试 |
| LEADER | 仪器设备 | ACS9522/晶振 | Design in | 样品已寄出等装配测试，预计11月 |
| Valiant | 网络 | 晶振 | Design in | 样品阶段 |
| 华为 | 传输 | 晶振 O11H | Design in | 设计阶段，预计最快11月份有样品 |
| 华为 | BBU/RRU | 晶振 T75 | Design in | 研发阶段，样品暂无预期 |
| 华为 | 无线 | 晶振O22 | DO | 沟通状态 |
| 慧睿思通 | 专网 | 晶振 O11 | Design in | 4季度完成新板子设计测试 |
| 泽惠通 | 公安 | 晶振 CM66G | Design in | 样品寄出，等客户测试 |
| ACALBFI | 网络设备 | 晶振 T75 T53 | Design in | 样品寄出客户重新设计板子4季度完成 |
|  |  |  |  |  |

四、下阶段工作计划

* 1. 华为38.88跟进测试进度和可能出现的问题，把握招标进度
	2. 华为O11H 10M的项目推进，尽快能验证最终版本提供测试样品
	3. 华为保持项目跟进与屈涛的沟通，看是否有机会送样品测试
	4. 华为已有编码，做好预测和交付
	5. 华为退货事件的处理，争取能减少对大普的负面影响和打分
	6. 海外客户跟进芯片的design in机会，推进LEADER /ECI/ Cytech的进度
	7. 晶振跟进海外客户的需求，样品跟进测试
	8. 国内陕西烽火、三元达跟进其新的项目机会和老型号订单
	9. 成都张振华客户，全部再梳理一遍，确保所有客户订单下达到大普，其次，发掘已有客户的新需求，开发新的潜在需求客户
	10. 其他小客户需求跟进，保证能及时供应需求，往大的机会上引导的可能性
	11. 把握可能潜在的大的机会，如泽惠通的模块需求，ACAL的T75需求；争取能拿到相对大的订单
	12. 新客户的开发，新的design in机会的把握，继续梳理之前联系的客户，看客户方面最近是否有新的变化；同时开发新的目标客户，寻找新的合作伙伴和机会

五、主要问题及市场情况

1. 华为项目O11H 10M的进度偏慢，时间在流失，最终留给替代测试的时间会不足
2. 华为105°TCXO 到目前为止尚未有可行的设计方案
3. TCXO方面我司与同级竞争对手有一定差距，体现在成本上，产品指标上。成本上市场上一般指标的TCXO成本比较低，有的都是消费类的价格；另外在低噪方面，我们还没有相应的系列产品，经常会有客户询问低噪TCXO。